**Pies de foto**

Foto-1: Los investigadores del grupo en Micro y Nanotecnologías de la UPC, de izquierda a derecha, Manel Domínguez, Luis Castañer, Sergi Gorreta; Vicente Jiménez; Lukasz Kowalski; Gema López y Santiago Silvestre. Crédito foto: UPC

Foto-4.jpg: La investigadora Gema López, en el laboratorio Sala Blanca del Campus Nord de la UPC. Crédito foto: UPC

Foto-13.jpg: Oblea de silicio con la que se han fabricado los chips que viajarán a Marte. Crédito foto: UPC

Foto-2: Los investigadores de la UPC Manel Domínguez y Gema López, a la entrada de la Sala Blanca, del Campus Nord, donde han fabricado los microchips para la misión Mars2020 de la NASA. Los chips fueron fabricados por la entonces doctoranda Teresa Atienza y Gema López. Crédito foto: UPC

Foto-3: El investigador Manel Domínguez, en la Sala Blanca de la UPC. Crédito foto: UPC

Foto-8: Oblea de silicio con los microchips en los que se trabaja en la Sala Blanca de la UPC. Crédito foto: UPC

Foto-5.jpg: La investigadora Gema López, trabajando en el laboratorio de la Sala Blanca de la UPC. Crédito foto: UPC

Foto-7: Prototipo de oblea de silicio con los microchips que se han fabricado para la misión Mars2020 de la NASA. Crédito foto: UPC

Foto-11 y Foto-12: Imágenes del sensor esférico en miniatura 3D fabricado en la UPC, para futuras misiones a Marte. La esfera tiene un diámetro de 10 mm y un peso de 3 g, y se divide en 4 sectores. En su interior hay incorporados 6 microchips de silicio similares a los de REMS, TWINS y MEDA que permiten medir la velocidad y el ángulo del viento en el planeta rojo. Crédito fotos: UPC

Foto-6-CAB-UPC-CRISA: Imagen de un conjunto de 4 'dados' que van incorporados a los cilindros del sensor de viento MEDA. Crédito foto: CAB / UPC / CRISA.

Foto-9-Rems.jpg: Imagen de uno de los chips de silicio de los sensores de viento REMS y TWINS (misiones anteriores de la NASA). El sensor de viento MEDA (para la misión Mars 2020) incorpora 60 chips similares en diferentes puntos de los cilindros. Crédito foto: UPC

Foto-10: Imagen de uno de los chips de silicio de los sensores de viento REMS y TWINS, y que lleva escrito los nombres de los investigadores que los desarrollaron. Crédito foto: UPC